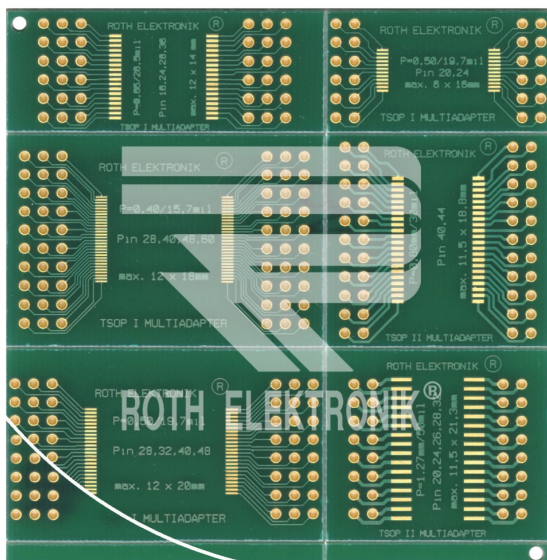


Multiadaptateur pour CMS TSOP I/II



RE900



- fibre de verre FR4 époxyde 1,50 mm, double face 35 µm CU (entièrement métallisées)
- côte soudure et composants avec une surface de nickel/d'or chimique (Ni/Au) et pourvus d'un masque d'arrêt de soudure
- distances entre les terminales:
0,40 mm (15.7 mil); 0,50 mm (19.7 mil)
0,65 mm (26.5 mil); 0,80 mm (30 mil); 1,27 mm (50 mil)
- perforation 1,00 mm
- platine d'adaptation pour 14 CMS TSOP I chips et 7 CMS TSOP II chips différents
- points destinés à la rupture pour séparer des modules de la platine
- les données Data Gerber d'apprêt pour l'établissement de l'application de pâte à braser seront mis à la disposition gratuitement
- dimensions: 72,60 x 76,20 mm

Modul-No	Typ	Pitch	Pin	Dim. max./mm
RE900-01	TSOP I	0,40	28,40,48,60	12 x 18
RE900-02	TSOP I	0,50	28,32,40,48	12 x 20
RE900-03	TSOP I	0,50	20,24	6 x 16
RE900-04	TSOP I	0,65	16,24,28,36	12 x 14
RE900-05	TSOP II	0,80	40,44	11,5 x 18,8
RE900-06	TSOP II	1,27	20,24,26,28,32	11,5 x 21,3